

## RESINES EPOXY ET POLYIMIDES, THERMOCONDUCTRICES, MONOCOMPOSANT\*

REF	RETICULATION Recommandée	DUREE DE VIE en pot	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	COEFFICIENT DE DILATATION		RESISTIVITE	UTILISATIONS
							AVANT TG	AVANT TG		
<b>E703FC</b>	5 min à 125°C	4 h à 25°C	2,5 Pa.S	70-80°C	350°C	51%	50-60.10 <sup>-6</sup> /°C	150-160.10 <sup>-6</sup> /°C	10 <sup>13</sup> Ω.cm	Collage de puces en silicium - Réticulation très rapide - Peu de volatiles
<b>E703HV</b>	5 min à 150°C	16 h à 25°C	10 Pa.S	70-80°C	> 350°C	51%	50-60.10 <sup>-6</sup> /°C	150-160.10 <sup>-6</sup> /°C	10 <sup>13</sup> Ω.cm	Collage de puces en silicium - Réticulation très rapide - Peu de volatiles - Visqueuse
<b>E703LF</b>	1 min à 140°C	7 jours à 25°C	10 Pa.S	70-80°C	> 350°C		50-60.10 <sup>-6</sup> /°C	150-160.10 <sup>-6</sup> /°C	10 <sup>13</sup> Ω.cm	Collage de puces - Technologie Lead free
<b>E703SC</b>	5 min à 125°C	5 jours à 25°C	12 Pa.S	70-80°C	> 350°C		50-60.10 <sup>-6</sup> /°C	150-160.10 <sup>-6</sup> /°C	10 <sup>13</sup> Ω.cm	Collage de puces en silicium - Réticulation très rapide - Peu de volatiles - Visqueuse
<b>E704LF</b>	1 min à 140°C	5 jours à 25°C	7,5 Pa.S	70-80°C	350-380°C		50-60.10 <sup>-6</sup> /°C	150-160.10 <sup>-6</sup> /°C	10 <sup>13</sup> Ω.cm	Collage de puces - Technologie Lead free
<b>E707-2</b>	30 min à 150°C	3 mois à 25°C	8 Pa.S	90-100°C	370-390°C	42%	40-50.10 <sup>-6</sup> /°C	120-150.10 <sup>-6</sup> /°C	10 <sup>13</sup> Ω.cm	Version monocomposant de la ref E707
<b>E707-2FV</b>	30 min à 150°C	5 jours à 25°C	17 Pa.S	90-100°C	370-390°C	42%	40-50.10 <sup>-6</sup> /°C	120-150.10 <sup>-6</sup> /°C	10 <sup>13</sup> Ω.cm	Version visqueuse de la E707-2
<b>E707-2LF</b>	30 min à 150°C	3 mois à 25°C	12 Pa.S	90-100°C	> 380°C		40-50.10 <sup>-6</sup> /°C	120-150.10 <sup>-6</sup> /°C	10 <sup>13</sup> Ω.cm	Collage de jauges de contraintes - Technologie Lead free
<b>E707-3</b>	30 min à 150°C	3 mois à 25°C	20 Pa.S	90-100°C	370-390°C		55-65.10 <sup>-6</sup> /°C	130-160.10 <sup>-6</sup> /°C	10 <sup>13</sup> Ω.cm	Protection au trempé de petits composants électroniques
<b>P101</b>	1 h à 150°C + 1 h à 275°C	6 mois à 25°C	11 Pa.S	175-205°C	576°C	60%	25-27.10 <sup>-6</sup> /°C	48-50.10 <sup>-6</sup> /°C	10 <sup>13</sup> Ω.cm	Résine polyimide. Collage thermoconducteur avec tenue à haute température
<b>P102</b>	1 h à 150°C + 1 h à 275°C	6 mois à 25°C	17 Pa.S	250-275°C	575°C				10 <sup>13</sup> Ω.cm	Résine polyimide. Collage thermoconducteur avec tenue à haute température

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

\* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 30/03/2009

**epotecny**

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epo